

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下 2 项担保合同：

1、公司已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请 2,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。

2、公司已与渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行签订《渤海银行股份有限公司最高额保证协议》，为全资子公司厦门信达半导体科技有限公司（以下简称“信达半导体”）向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请 500 万元的融资额度提供连带责任担保，期限为 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 9 月 17 日。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的二〇二一年第一次临时股东大会审议通过公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

本次担保提供后，公司对前述 2 家子公司的担保情况如下：

2021 年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

被担保方	资产负债率	为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度	资产负债率低于 70%的全资子公司尚在担保期限内的担保余额	剩余 2021 年度内资产负债率低于 70%的全资子公司可用担保额度
福建信田	39.47%	人民币 350,000 万元	人民币 18,000 万元	人民币 332,000 万元
被担保方	资产负债率	为资产负债率高于 70%的全资子公司提供担保额度	资产负债率高于 70%的全资子公司尚在担保期限内的担保余额	剩余 2021 年度内资产负债率高于 70%的全资子公司可用担保额度

	债率	70%的全资子公司提供担保额度	的全资子公司尚在担保期限内的担保余额	负债率高于70%的全资子公司可用担保额度
信达半导体	79.12%	人民币 350,000 万元 +美元 69,800 万元	人民币 13,550 万元	人民币 336,450 万元+ 美元 69,800 万元

注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1、福建信田汽车有限公司

成立时间：2002 年 8 月 16 日

注册地：福州市仓山区则徐大道 631 号

法定代表人：罗耀煌

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：摩托车及零配件、机械电子设备、润滑油、轮胎、金属材料的批发、零售；汽车装饰装璜；汽车信息咨询服务；广州本田品牌汽车销售；进口本田品牌汽车销售；一类汽车维修；乘用车维修等。

股东及持股比例：公司及公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司分别持有该公司 20%及 80%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额 6,428.21 万元，负债总额 2,537.45 万元，净资产 3,890.76 万元；2019 年度，营业收入 31,794.58 万元，利润总额 101.82 万元，净利润 68.29 万元。截至 2020 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 6,270.81 万元，负债总额 1,995.53 万元，净资产 4,275.28 万元；2020 年 1-11 月，营业收入 30,004.26 万元，利润总额 527.96 万元，净利润 384.52 万元。福建信田不是失信被执行人。

2、厦门信达半导体科技有限公司

成立时间：2019 年 4 月 29 日

注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 12 号

法定代表人：高新颜

注册资本：8,000 万元人民币

主营业务：半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。

截至2019年12月31日（经审计），公司资产总额3,362.72万元，负债总额1,570.02万元，净资产1,792.69万元；2019年度，营业收入330.98万元，利润总额-1,207.31万元，净利润-1,207.31万元。截至2020年11月30日（未经审计），公司资产总额21,138.88万元，负债总额16,725.53万元，净资产4,413.35万元；2020年1-11月，营业收入10,771.64万元，利润总额-2,379.35万元，净利润-2,379.35万元。信达半导体不是失信被执行人。

三、合同主要内容

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保范围	期限	担保方式
厦门信达	福建信田	中国光大银行股份有限公司福州分行	2,000 万元	2,000 万元融资额度	1 年	连带责任担保
厦门信达	信达半导体	渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行	500 万元	500 万元融资额度	2021 年 3 月 8 日至 2021 年 9 月 17 日	连带责任担保

四、反担保情况

福建信田及信达半导体系公司全资子公司，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司2021年度经审议对全资及控股子公司担保额度为人民币1,050,000万元+美元69,800万元。其中，2021年度新签署的担保金额合计为人民币41,550万元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.99%，剩余可用担保额度为人民币1,008,450万元+美元69,800万元。

截至公告日，公司实际对外担保总余额为人民币 381,134.21 万元+美元 12,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 200.11%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日